

2016年12月27日

銅張積層板および内層回路入り多層基板材料の価格改定について

パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社は、電子回路基板用材料として販売している銅張積層板及び内層回路入り多層基板材料(当社製品名:プレマルチ)の価格を改定致します。

銅張積層板及び内層回路入り多層基板材料の原材料のひとつである銅箔の価格は、世界的に需給が逼迫し、高騰が続いています。また、銅箔の原料である銅インゴットの価格指標となるLME(London Metal Exchange:ロンドン金属取引所)価格も上昇しており、銅箔価格に影響を与えています。

これまで当社では、原材料費の増加分を製造の合理化や費用削減などで吸収すべく、全力を上げて取り組んでまいりましたが、銅箔価格上昇分の全てを自助努力で吸収するには限界があり、お客様への安定的な製品供給の観点からも、銅箔価格の上昇分の一部を以下の通り製品価格に反映させていただくこととなりました。

■価格改定対象製品と現行価格に対する改定幅

対象製品	現行価格に対する改定幅
銅張積層板	現行価格の+10%
内層回路入り多層基板材料 (当社製品名:プレマルチ)	現行価格の+5%

■実施時期

2017年1月1日出荷分より

【お問合せ先】

オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 電子材料事業部
https://industrial.panasonic.com/cuif/jp/contact-us?field_contact_group=2201&field_contact_lineup=3248&ad=press20161227

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。